

附件一

电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共 6 项，其中自主可控 A 级 0 项、B 级 6 项、C 级 0 项、C*级 0 项、D 级 0 项、E 级 0 项；伪国产化 0 项、包装国产化 0 项、空心国产化 0 项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



2025 年 06 月 17 日

附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	生产厂商 ^c	自主可控等级 ^d	是否“伪国产化” ^e		是否“包装国产化” ^e		是否“空心国产化” ^e		备注 ^e
					是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	逻辑门电路	JTLX1G14XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
2	逻辑门电路	JTLX1G14XC5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
3	逻辑门电路	JTLX1G14XF5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
4	逻辑门电路	JTLX1G14XC5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
5	逻辑门电路	TLX1G14XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
6	逻辑门电路	TLX1G14XC5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

填表说明:

- a.应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- b.应填写元器件完整型号规格；
- c.应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；
- d.按照 ZKB 3101-001-2022 《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行，分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级，针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行；

填报单位（盖章）:

法定代表人（签章）:

填表人（签字）:

电话:

填报日期: 20250617

- e. “伪、空、包” 应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为 “是” 时，则需要在 “情况说明” 写明判别因素；若为 “否” 时，则填 “无” ；
- f. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。



填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

汤学明

填表人（签字）

姜春雷

电话：

18226090182

填报日期：20250617

附表二

电子元器件基本信息表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	使用 IP 核情况 ^c				原材料和零部件 ^d				流片工艺 ^g		备注
			名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否“核心”/“关键” ^e	来源单位 ^f	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	逻辑门电路	JTLX1G14XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	长电				
2	逻辑门电路	JTLX1G14XC5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	长电				
3	逻辑门电路	JTLX1G14XF5 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	长电				
4	逻辑门电路	JTLX1G14XC5 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	长电				
5	逻辑门电路	TLX1G14XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	长电				
6	逻辑门电路	TLX1G14XC5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	长电				

填表说明:

a.应是元器件全称,与详细规范或产品技术资料上的名称相符;

b.应填写元器件完整型号规格;

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话:

填报日期: 20250617



- c.仅适用于半导体集成电路，应填写 IP 核类型，包括“软核”“固核”“硬核”；
- d.本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写，至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料，同时也应包含外壳、引出端、键合丝等，不包含灌封料等生产过程材料；
- e.应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”，非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填；
- f.应根据实际设计单位或生产商情况填写，不能按代理商填写；对来源不明的，应填写“来源不明”，具体判定时视为“境外”；
- g.仅适用于半导体集成电路，应填写流片工艺名称，如 45nmBCD 工艺等，必要时在备注中填写流片厂商信息。



填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

填表人（签字）

电话：

填报日期：20250617